

エレクトロニクスの機能を具現化する全てがココにある!!

電子機器2024 トータルソリューション展

www.jpccashow.com



JPCA 2024
Show

第53回 国際電子回路産業展



マイクロエレクトロニクスショー

第38回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO
PROTEC 2024

第25回 実装プロセステクノロジー展

METAVVERSE DEVICE EXPO
メタバースデバイス展

メタバースデバイス展



~装置と装置をつなぐ~

WIRE Japan Show
2024

電気・光伝送技術展

Electronics
Component & Unit
Show

JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合



E-Textile/Wearable

イーテキスタイル/ウェアラブル展



Smart Sensing

スマートセンシング



無人化ソリューション展



Edge Computing

エッジコンピューティング

結果報告書

出展者数：438社 小間数：1,230小間 / 来場者数 48,334名

2024. 6. 12_{Wed.} → 14_{Fri.} 10:00-17:00

東京ビッグサイト 東展示棟 3~6ホール

www.jpccashow.com

本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpcca.org

展示会運営事務局：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 12F TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpccashow@jtbcom.co.jp

ご挨拶

「電子機器トータルソリューション展2024 (JPCA Show、マイクロエレクトロニクスショー、JISSO PROTEC、メタバースデバイス展、WIRE Japan Show、Electronics Component & Unit Show、E-Textile/Wearable、Smart Sensing、無人化ソリューション展、Edge Computing)」は、2024年6月12日(水)～6月14日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催され、出展者数438社、出展小間数1,230小間で盛況裡に無事終了することができました。

これもひとえに、ご後援を賜りました経済産業省をはじめ、協賛団体各位、ご出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

次回開催は、2025年6月4日(水)～6月6日(金)「電子機器トータルソリューション展2025」を東京ビッグサイト 東展示棟で予定しておりますので、ご出展・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ここに、今回の結果をご報告申し上げますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

実施概要



展示会運営委員会
委員長
高井 建郎



(一社)日本電子回路工業会
会長
小林 俊文



(一社)エレクトロニクス実装学会
会長
藤崎 晃



(一社)日本ロボット工業会
会長
橋本 康彦



(株)産業タイムズ社
取締役会長
泉谷 渉



(株)工業通信
代表取締役社長
井上 政基



全国電子部品流通連合会
会長
屋宮 芳高



株式会社JTBCコミュニケーションデザイン
代表取締役 社長執行役員
藤原 卓行



(株)織研新聞社
代表取締役社長
佐々木 幸二

■ 会 期：2024年6月12日(水)～14日(金)

■ 開催時間：10:00～17:00

■ 会 場：東京ビッグサイト 東3～6ホール

■ 名 称：**JPCA Show 2024 第53回国際電子回路産業展**

構成展示会：2024 プリント配線板技術展
2024 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
2024 機器・半導体受託生産システム展
【ゾーン】自動運転向け高速伝送技術
【ゾーン】EV向け大電流技術
【ゾーン】パワー半導体/ガラス基板向け材料・プロセス技術
【ゾーン】アドバンスドパッケージング技術
【ゾーン】気候変動対策：低エミッション技術

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

JISSO PROTEC 2024

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会

WIRE Japan Show 2024 電気・光伝送技術展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
電線新聞 ((株)工業通信)

E-Textile/Wearable イーテキスタイル/ウェアラブル展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
株式会社織研新聞社

無人化ソリューション展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
株式会社JTBCコミュニケーションデザイン

■ 後 援：経済産業省

■ 海外協力：世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体：CPCA (中国電子回路行協会)、EIPC (欧州電子回路協会)、ELCINA (印度電子工業会)、HKPCA (香港線路板協会)、IPC (米国電子回路協会)、IPCA (印度電子回路工業会)、KPCA (韓国電子回路産業協会)、THPCA (タイ電子回路工業会)、TPCA (台湾電路板協会)
KPIA (Korea Packaging Integration Association)、AEIS (Association of Electronic Industries in Singapore)

■ 本部事務局：一般社団法人 日本電子回路工業会 (JPCA)

■ 協 賛：一般社団法人映像情報メディア学会、画像センシング技術研究会、一般社団法人画像電子学会、一般社団法人カメラ映像機器工業会、技術研究組合光子融合基盤技術研究所、一般社団法人組込みシステム技術協会、公益社団法人自動車技術会、日本フォトイメージング協会、一般社団法人情報サービス産業協会、一般社団法人情報処理学会、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会、SEMIジャパン、全国鍍金工業組合連合会、一般社団法人ソフトウェア協会、太陽光発電技術研究組合、一般社団法人電気学会、一般社団法人電気設備学会、一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人電子情報通信学会、銅箔工業会、一般社団法人日本アミューズメント産業協会、一般社団法人日本医療機器工業会、一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会、一般社団法人日本印刷産業連合会、一般社団法人日本オーディオ協会、一般社団法人日本音響学会、一般社団法人日本火災報知機工業会、一般社団法人日本金型工業会、一般社団法人日本機械工業連合会、一般社団法人日本金属熱処理工業会、一般社団法人日本計量機器工業連合会、一般社団法人日本検査機器工業会、一般社団法人日本材料科学会、一般社団法人日本産業機械工業会、一般財団法人日本自動車研究所、一般社団法人日本自動車部品工業会、一般社団法人日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、一般社団法人日本電気協会、一般社団法人日本電気計測器工業会、一般社団法人日本電機工業会、一般社団法人日本電気制御機器工業会、一般社団法人日本照明工業会、一般社団法人日本電子デバイス産業協会、一般財団法人日本電子部品信頼性センター、一般社団法人日本電線工業会、一般社団法人日本農業機械工業会、一般社団法人日本配線システム工業会、一般社団法人日本半導体製造装置協会、一般社団法人日本表面処理機材工業会、公益社団法人日本表面真空学会、一般社団法人日本ファインセラミックス協会、公益社団法人日本分析化学会、一般社団法人日本分析機器工業会、一般社団法人日本ベアリング工業会、一般社団法人日本遊技関連事業協会、一般社団法人日本溶接協会、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会、一般社団法人表面技術協会、一般財団法人ファインセラミックスセンター、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会、(一社)日本ドローンコンソーシアム (JDC)、(一社)日本UAS産業振興協議会 (JUIDA)、(一社)日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、電気硝子工業会 (順不同・敬称略)

■ 展示会運営事務局：株式会社JTBCコミュニケーションデザイン

2024 マイクロエレクトロニクスショー 第38回 最先端実装技術・パッケージング展

同時開催：最先端実装技術シンポジウム

アカデミックプラザ
eX-tech 2024

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)

メタバースデバイス展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
電子デバイス産業新聞 ((株)産業タイムズ社)

Electronics Component & Unit Show

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
全国電子部品流通連合会 / 東京都電機卸商業協同組合

Smart Sensing 2024 スマートセンシング

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会
株式会社JTBCコミュニケーションデザイン

Edge Computing エッジコンピューティング

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
株式会社JTBCコミュニケーションデザイン

スポンサーシップ

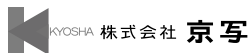
Platinum Sponsor



Gold Sponsor



Silver Sponsor



Bronze Sponsor



スポンサープログラムの主な内容

●会期前

メールマガジン広告(ヘッダ・センター)

●会期前～中

公式サイトトップページバナー

●会期中

NEW ガレリアエスカレータ下デジタルサイネージへの広告掲載 / **NEW** 会場入口デジタルサイネージへの広告掲載 / **NEW** 開会式会場デジタルサイネージへのロゴ掲載 / 会場フロアマップへのロゴ掲載 / 基調講演スクリーンロゴ投影 / **NEW** 会場内巡回自立走行型ロボットへの社名・ロゴ掲載

展示会結果概要

展示会・セミナーともに大盛況!

出展者数

438

社・団体

小間数

1,230

小間

来場者数

48,334名

セミナー数

165本

広報活動

(1) 関連業界団体との連携強化

メールマガジンの配信や機関誌への広告掲載など相互の展示会においてプロモーション活動を実施。

(2) 広告掲載媒体 (順不同)

エレクトロニクス実装技術/メカトロニクス/プリント回路ジャーナル/織研新聞/電子デバイス新聞/電波新聞/電線新聞/化学工業日報/新製品情報/日刊工業新聞/科学情報出版HP/CEND/プロダクトナビ/製品ナビ/基板の窓口

(3) 海外展示会出展・広告掲載実績

2023年 9月 6日(水)～ 8日(金) 韓国: KPCA Show 2023

10月 25日(水)～ 27日(金) 台湾: TPCA Show 2023

11月 7日(火)～ 8日(水) 中国: 日中電子回路秋季大会

12月 6日(水)～ 8日(金) 香港: HKPCA Show 2023

2024年 5月 13日(月)～ 15日(水) 中国: 国際電子回路(上海) 展覧会 (CPCA Show 2024)

(4) PRツール製作

国内用招待状(225,000枚)、海外用招待状(データ配布)、VIP招待券(27,000枚)、ポスター(400枚)

(5) メールマガジンの配信

関連する業界団体やスポンサー企業などの協力により、会期1ヶ月前よりメールマガジン配信を実施。

(6) メディア発表会の実施

昨年に引きつづき、開幕に先駆け、5月31日(金)よりオンラインにてメディア発表会を実施。

開会式

●日 時：6月12日(水) 9:45～10:00

●会 場：東京ビッグサイト 東3ホール内セミナー会場A(基調講演会場)

| | | | |
|------|----------------|----------------------|-------------------|
| 来賓 | 西村 秀隆 | 経済産業省 | 審議官(商務情報政策局担当) |
| 開催挨拶 | 小林 俊文 | 一般社団法人日本電子回路工業会 | 会長 |
| | 高井 建郎 | 一般社団法人日本電子回路工業会 | 展示会運営委員長 |
| | 齊藤 文靖 | 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 | 副会長 |
| | 太田 裕之 | 一般社団法人日本ロボット工業会 | 副会長 |
| | 泉谷 涉 | 株式会社産業タイムズ社 | 取締役会長 |
| | 井上 政基 | 株式会社工業通信 | 代表取締役社長 |
| | 塩谷 久美子 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 執行役員 事業共創部長 |
| | 屋宮 芳高 | 全国電子部品流通連合会 | 会長 |
| | 藤浦 修一 | 株式会社織研新聞社 | 執行役員 |
| | XU HUAN | 中国電子回路行業協会(CPCA) | Vice Chairman |
| | Luther WONG | 香港線路板協会(HKPCA) | Vice Chairman |
| | Chuck Li | 米国電子回路協会(IPC) | Standards Manager |
| | Cho Byeong Hak | 韓国電子回路産業協会(KPCA) | Vice President |
| | Daniel Primett | タイ電子回路工業会(THPCA) | THPCA Board |
| | Lawrence Chang | 台湾電路板協会(TPCA) | Vice Chairman |

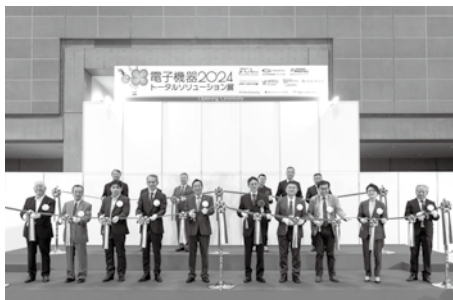
ウェルカムレセプション

出展企業及び業界関係者約400名が参加。御来賓として、経済産業大臣 政務官 吉田 宣弘様にご挨拶をいただいた。

●日 時：6月12日(水) 17:30～18:30

●会 場：東京ビッグサイト 東3ホール内セミナー会場A(基調講演会場)

| | | | |
|------|--------|----------------------|-------------------|
| 挨拶 | 小林 俊文 | 一般社団法人日本電子回路工業会 | 会長 |
| 来賓挨拶 | 吉田 宣弘 | 経済産業省 | 経済産業大臣政務官 |
| 乾杯登壇 | 吉田 宣弘 | 経済産業省 | 経済産業大臣政務官 |
| | 小林 俊文 | 一般社団法人日本電子回路工業会 | 会長 |
| | 高井 建郎 | 一般社団法人日本電子回路工業会 | 展示会運営委員長 |
| | 山下 博樹 | 一般社団法人日本電子回路工業会 | 副会長 |
| | 倉田 司 | 一般社団法人日本電子回路工業会 | 副会長 |
| | 山道 新太郎 | 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 | 副会長 |
| | 太田 裕之 | 一般社団法人日本ロボット工業会 | 副会長 |
| | 泉谷 涉 | 株式会社産業タイムズ社 | 取締役会長 |
| | 井上 政基 | 株式会社工業通信 | 代表取締役社長 |
| | 長谷川 裕久 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 事業共創部 トレードショー事業局長 |
| | 屋宮 芳高 | 全国電子部品流通連合会 | 会長 |
| | 藤浦 修一 | 株式会社織研新聞社 | 執行役員 |
| 乾杯発声 | 太田 裕之 | 一般社団法人日本ロボット工業会 | 副会長 |
| 中締挨拶 | 山道 新太郎 | 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 | 副会長 |



開会式テープカット



吉田経済産業大臣政務官のご挨拶



ウェルカムレセプション乾杯

学生向けオリエンテーション&ツアー

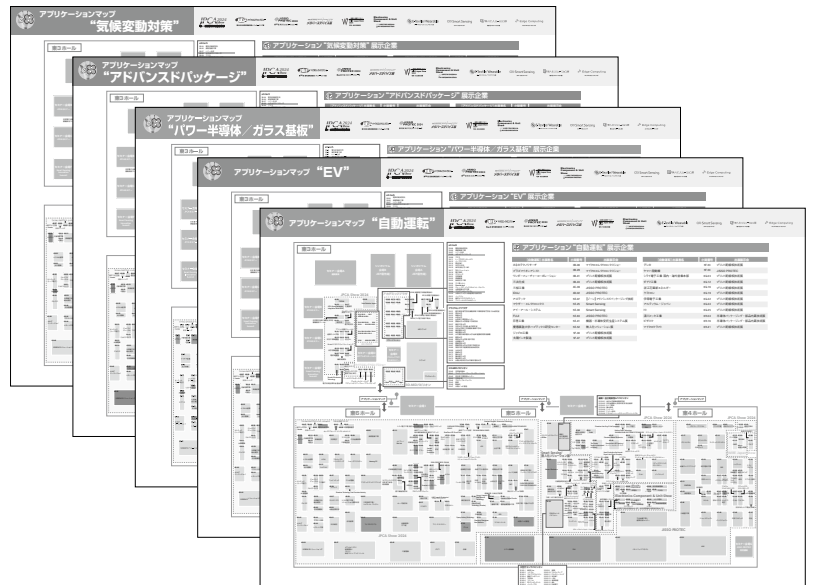
学生の皆様へ業界についての深い知識と理解を得ていただくために展示会オリエンテーション&ツアーを実施。
学生の皆様のお立ち寄りを特に歓迎する出展者様には“学生ウェルカムブース”としてご参加いただきました。

●日 時：各日とも 10:30～11:15 オリエンテーション / 11:15～12:00 展示会ツアー



アプリケーションマップ

業界が注目するアプリケーション分野を分類し、それぞれに関連する製品や技術を保有する出展者をマップで会場入口に示し、また展示会公式サイトでも掲載しました。



ブースコンテスト

前回に引き続きブースコンテストを実施。

ブースコンテストは、出展企業の中から、ブースデザインの装飾を対象とした【ナイスデザイン賞】、展示内容のわかりやすさ、見やすさを対象とした【ベスト展示賞】、パッケージブースの効果的利用を対象とした【特別審査員賞】の3つの賞を設け、来場者投票により決定した。

表彰式 ●日 時：6月14日(金) 10:15～10:30 ●会 場：東3ホール内セミナーB会場



ナイスデザイン賞・ベスト展示賞

【小間番号:5F-54】

ヤマハ発動機株式会社

W受賞!

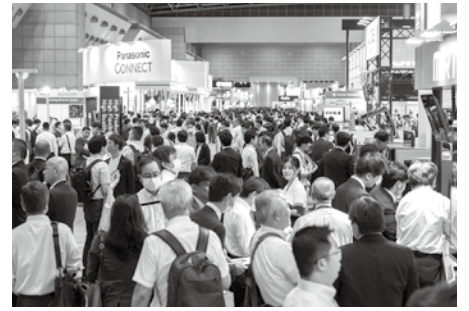
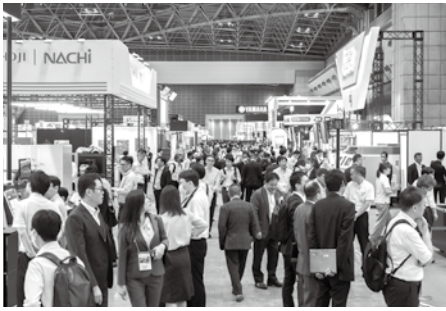


特別審査員賞

【小間番号:3A-06】

株式会社SIJテクノロジー





セミナー会場 H

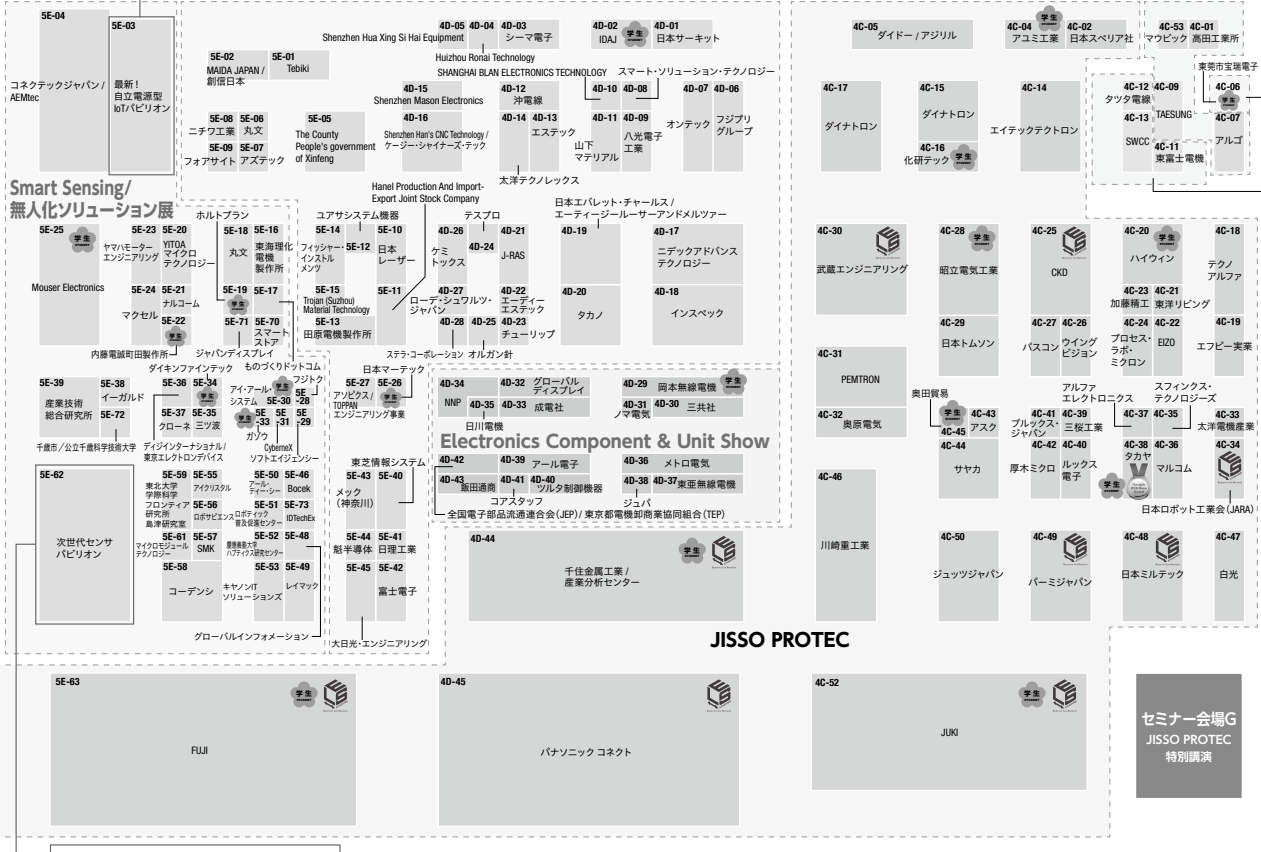
最新! 自立電源型IoTパビリオン

- SE-03-01 金沢大学振動発電研究室
- SE-03-02 住友金属鉱山 技術本部 技術企画部
- SE-03-03 ヤシマ電気
- SE-03-04 横山商会
- SE-03-05 リンテック
- SE-03-07 アイシン高丘
- SE-03-08 エネルギーハーベスティングコンソーシアム

JPCA Show 2024

東4ホール

JPCA Show 2024



- 次世代センサパビリオン**
- SE-62-1 MODE, Inc.
 - SE-62-2 ソラコム
 - SE-62-3 アルファアルバイオン
 - SE-62-4 藤倉コンポジット
 - SE-62-5 TOPPAN
 - SE-62-6 マクニカ
 - SE-62-7 FG コーポレーション
 - SE-62-8 インターポロ
 - SE-62-9 南陽
 - SE-62-10 マルティスラップ
 - SE-62-11 デルタツクリン
 - SE-62-12 SUPWAT
 - SE-62-13 I-PRD
 - SE-62-14 泰興物産
 - SE-62-15 AML
 - SE-62-16 日東電工



出展者一覧

JPCA Show 2024

プリント配線板技術展

| | |
|--|-------|
| 愛工機器製作所 | 6G-31 |
| IDAJ | 4D-02 |
| IPC (米国電子回路協会) | 3B-79 |
| アイン | 6G-02 |
| 赤羽産業 | 6H-42 |
| アスリートFA | 6H-44 |
| アドテックエンジニアリング | 6H-24 |
| アトテックジャパン | 5F-07 |
| アルゴ | 4C-07 |
| アルティウム ジャパン | 6G-24 |
| アルパトロテック | 6G-01 |
| アルメックテクノロジーズ | 6H-19 |
| イー・エス・アイ・ジャパン | 5F-07 |
| EME | 5F-10 |
| Yiyang Jindong Technology | 5F-52 |
| 石井表記 | 6H-43 |
| 石原ケミカル | 5F-34 |
| イチカワテクノファブリクス | 5F-08 |
| 伊原電子工業 | 6G-22 |
| インスベック | 4D-18 |
| 盈華電子科技 | 5F-35 |
| 上村工業 | 5F-12 |
| ウシオ電機 | 6H-25 |
| HKPCA (香港線路板協会) | 3B-78 |
| エイト工業 | 6G-27 |
| エーディーエステック | 4D-22 |
| エーティージールーサーアンドメルツァー | 4D-19 |
| NTW Inc. | 6G-28 |
| LPKF Laser & Electronics | 6G-34 |
| オーク製作所 | 6G-38 |
| 大船企業日本 | 6H-38 |
| 鉅椽企業 | 5F-42 |
| オカダジーエージェイ | 6H-46 |
| オルガン針 | 4D-25 |
| オンテック | 4D-07 |
| 科学情報出版 | 3A-10 |
| 華正新材料 | 5F-46 |
| カネカ | 6G-14 |
| 広東駿亜電子科技 | 6G-29 |
| 北川精機 | 6H-23 |
| Camelot Electronics Technology | 3A-01 |
| 協栄プリント技研 | 5F-05 |
| 京写 | 6G-05 |
| 建滔積層板 | 6G-32 |
| 熊本県 | 3A-19 |
| クラブオウ | 6G-37 |
| Kunshan DongWei Science and Technology | 5F-03 |
| ケージー・シャイナーズ・テック | 4D-16 |
| KPIA (Korea Packaging Integration Association) | 3A-25 |
| KPCA (韓国電子回路産業協会) | 3B-76 |
| ケミックス | 4D-26 |
| ケミロン | 6G-19 |
| GOAL SEARCHERS, ZHUHAI | 6G-15 |
| コニカミノルタ | 5F-14 |
| 堺化学工業 | 5F-36 |
| The County People's government of Xinfeng | 5E-05 |
| 相模ピーシーアイ | 6G-08 |
| 佐藤商事 | 6G-40 |
| 山栄化学 | 5F-31 |
| 三晃技研工業 | 6H-35 |

| | |
|--|-------|
| Sunshine Global Circuits | 5F-40 |
| サンテック (トーア電子) | 6H-32 |
| CPCA (中国電子回路産業協会) | 3B-77 |
| JSR | 5F-48 |
| ジェイティディーエム | 6H-30 |
| JPCA めっき委員会 | |
| J-RAS | 4D-21 |
| JCU | 5F-15 |
| ShenZhen JCD Circuit Tech | 5F-20 |
| SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY | 5F-25 |
| Shenzhen Technology Trust Precision Industry | 6H-26 |
| Shenzhen Han's CNC Technology | 4D-16 |
| Shenzhen Mason Electronics | 4D-15 |
| 四会富仕電子科技 | 6G-20 |
| 四国化成工業 | 5F-29 |
| 澁谷工業 | 6G-36 |
| ジャブロ工業 | 5F-30 |
| Jiangxi Jiangnan New Material Technology | 5F-44 |
| JIANGXI LIYUAN HAINA TECHNOLOGY | 5F-01 |
| Jiangsu Suhang Electronics | 6G-07 |
| Shandong Shengquan New Materials | 5F-51 |
| SHANGHAI BLAN ELECTRONICS TECHNOLOGY | 4D-10 |
| 上海山崎电路板 | 6G-04 |
| シュマルツ | 6H-21 |
| シュモール・マシネン | 6H-35 |
| 松和産業 | 5F-23 |
| ショーダテクトロン | 6H-18 |
| スライ電子工業 国内・海外営業本部 | 6G-03 |
| スライ電子工業 ソリューション事業本部 | 6H-36 |
| 信維通信日本 | 6G-11 |
| 真華成 | 5F-02 |
| 伸光製作所 | 6G-10 |
| 新興電気 | 6H-47 |
| 深圳市ニューセス実業 | 5F-27 |
| SCREEN PEソリューションズ | 6H-48 |
| ステラ | 6H-47 |
| ステラ・コーポレーション | 4D-28 |
| スマート・ソリューション・テクノロジー | 4D-08 |
| Sowotech | 6G-21 |
| 嵩台資訊 | 6H-39 |
| 台強電機 | 6H-33 |
| 太陽インキ製造 | 5F-47 |
| ダイワ | 6G-41 |
| ダイワ工業 | 6G-12 |
| 高田工業所 | 4C-01 |
| タカノ | 4D-20 |
| タケウチ | 6H-34 |
| タツタ電線 | 5F-16 |
| CHEON WESTERN (CHINA) GROUP | 5F-06 |
| ちの技研 | 6G-26 |
| China Circuit Technology(Shantou) | 5F-45 |
| チューリップ | 4D-23 |
| 長興材料工業 | 5F-24 |
| ZHEJIANG EMIDA PUMPS | 5F-04 |
| ZHEJIANG HUANERGY | 6G-16 |
| 角田ブラシ製作所 | 5F-32 |
| DIC | 5F-21 |
| THPCA (タイ電子回路工業会) | 3B-75 |
| TPCA (台湾电路板協会) | 3B-80 |
| DDPスペシャルティ・プロダクツ・ジャパン | 5F-09 |
| テスプロ | 4D-24 |
| TAESUNG | 4C-09 |
| 科恵 (澳門) 線路 | 6G-32 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Tebiki | 5E-01 |
| デンカ | 5F-53 |
| 電子回路企業年金基金 | 3A-02 |
| 天津普林電路 | 6G-23 |
| 東海神栄電子工業 | 6G-30 |
| 東京マシン・アンド・ツール | 6H-47 |
| 惠州東和数碼科技 東和デジテック | 6G-06 |
| 東和プリント工業 | 6G-06 |
| ト | 6G-25 |
| Trojan (Suzhou) Material Technology | 5E-15 |
| 中島化学産業 | 5F-42 |
| ナラサキ産業 | 6H-22 |
| ニッカン工業 | 5F-37 |
| 日刊工業新聞社 | 3A-13 |
| ニッコー・マテリアルズ | 5F-24 |
| 日東紡績 | 5F-50 |
| 日本ゼオン | 6G-33 |
| ニテックアドバンステクノロジー | 4D-17 |
| 日本アグフアマテリアルズ | 5F-18 |
| 日本エバレット・チャールス | 4D-19 |
| 日本化学工業 | 5F-11 |
| 日本サーキット | 4D-01 |
| 日本製鋼所 | 6H-40 |
| 日本電子回路工業会 (JPCA) 書籍販売コーナー | 3A-22 |
| 日本レーザー | 5E-10 |
| 伯東 | 5F-55 |
| ピアメカニクス | 6H-47 |
| PCBGOGO | 5F-19 |
| ビーム | 6G-18 |
| 日立ハイテクサイエンス | 6G-17 |
| 平山ファインテクノ | 5F-22 |
| ファインテック | 6H-27 |
| ブイ・テクノロジー | 6G-39 |
| フィッシャー・インストルメンツ | 5E-14 |
| 福田金属箔粉工業 | 5F-41 |
| フジ機工 | 6H-29 |
| 不二越 | 6G-40 |
| フジブリグループ | 4D-06 |
| 藤森工業 | 5F-43 |
| Pudu Robotics Japan | 3B-39 |
| プリント回路ジャーナル | 3A-18 |
| プリント電子研究所 | 3A-21 |
| ブルックスジャパン | 6G-34 |
| ベアック | 6H-28 |
| マイクロラフト | 6H-41 |
| MAIDA JAPAN/ 創信日本 | 5E-02 |
| マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン | 5F-17 |
| マコー | 6G-09 |
| マックエイト | 6G-27 |
| 丸源鐵工所 | 6H-39 |
| ミカドテクノス | 6H-31 |
| マイクロ技術研究所 | 5F-33 |
| 三菱ガス化学 | 5F-38 |
| 三菱電機 | 6G-42 |
| ムラキ | 6H-20 |
| メイコー | 6G-13 |
| MeiLink | 6G-13 |
| メック (兵庫) | 5F-26 |
| モトロニクス | 6H-37 |
| ユアサシステム機器 | 5E-12 |
| ユニオンツール | 5F-49 |
| ヨクスル | 3A-09 |
| ライズエレクトロニクス | 6G-32 |

| | |
|----------------|-------|
| 利昌工業 | 5F-39 |
| レヨン工業 | 6H-44 |
| ローデ・シュワルツ・ジャパン | 4D-27 |
| YMT | 5F-28 |

3D-MIDパビリオン

| | |
|--------------------|-------|
| アルティウム ジャパン | 3B-44 |
| 岩手県工業技術センター | 3B-42 |
| EBINAX | 3B-46 |
| 三共化成 | 3B-43 |
| 図研 | 3B-45 |
| 太陽インキ製造 | 3B-47 |
| 日本MID協会 | 3B-40 |
| ワンダーフューチャーコーポレーション | 3B-41 |

JPCA 半導体パッケージング・部品内蔵技術展

| | |
|-----------------------|-------|
| Averatek | 6H-07 |
| アメリカンエクスプレス・インターナショナル | 6H-05 |
| エクシール | 6H-10 |
| 奥野製薬工業 | 6H-08 |
| オックスフォード・インストゥルメント | 6H-03 |
| 清川メッキ工業 | 6H-04 |
| 三喜製作所 | 6H-11 |
| STAR-J | 6H-15 |
| 電波新聞社 | 3A-07 |
| 東洋アルミニウム | 6H-07 |
| TOPPAN | 3A-28 |
| 内藤電誠工業 | 6H-14 |
| 長瀬産業 | 6H-13 |
| 日放電子 | 6H-12 |
| 日本電気硝子 | 6H-01 |
| 日本バーンズ | 6H-06 |
| ビザスク | 6H-16 |
| Haesung DS | 6H-17 |
| 三井化学ICTマテリア | 6H-02 |
| 三井金属鉱業 | 6H-09 |

JPCA フレキシブルプリント配線板製品出展エリア

| | |
|------------------------------------|-------|
| エステック | 4D-13 |
| 沖電線 | 4D-12 |
| シーマ電子 | 4D-03 |
| Shenzhen Hua Xing Si Hai Equipment | 4D-05 |
| 太洋テクノレックス | 4D-14 |
| 八光電子工業 | 4D-09 |
| Huizhou Ronai Technology | 4D-04 |
| 山下マテリアル | 4D-11 |

JPCA 機器・半導体受託生産システム展

| | |
|--|-------|
| アソピクス | 5E-27 |
| インコム | 3A-15 |
| 魁半導体 | 5E-44 |
| 大日光・エンジニアリング | 5E-45 |
| 田原電機製作所 | 5E-13 |
| 東芝情報システム | 5E-40 |
| TOPPAN エンジニアリング事業 | 5E-27 |
| 日理工業 | 5E-41 |
| 日本マーテック | 5E-26 |
| Hanel Production And Import-Export Joint Stock Company | 5E-11 |
| 富士電子 | 5E-42 |
| マウビック | 4C-53 |
| メック(神奈川) | 5E-43 |

【ゾーン】アドバンスドパッケージング技術

| | |
|-------|-------|
| アズテック | 5E-07 |
| 丸文 | 5E-06 |

【ゾーン】パワー半導体/ガラス基板向け材料・プロセス技術

| | |
|-------|-------|
| ニチワ工業 | 5E-08 |
|-------|-------|

| | |
|--------|-------|
| フォアサイト | 5E-09 |
|--------|-------|

2024 マイクロエレクトロニクスショー

| | |
|---------------------|-------|
| アールエスコンポーネンツ | 3B-01 |
| アディソククリアーウェーブコーティング | 3B-03 |
| ヴェオールイメージング | 3B-02 |
| SIJテクノロジー | 3A-06 |
| エレクトロニクス実装学会 (JIEP) | 3A-03 |

eX-tech

| | |
|-----------------------|-------|
| 秋田化学工業 | 3B-23 |
| アテネ | 3B-09 |
| アンドールシステムサポート | 3B-35 |
| イープロニクス | 3B-12 |
| エスベック | 3B-19 |
| 大阪公立大学/大阪産業技術研究所 | 3B-30 |
| 大阪有機化学工業 | 3B-28 |
| 奥野製薬工業 | 3B-06 |
| カネカテクノリサーチ | 3B-08 |
| JNC | 3B-16 |
| JNC 石油化学 | 3B-16 |
| Shimada Appli | 3B-25 |
| 星光PMC | 3B-14 |
| 太洋工作所 | 3B-15 |
| ティー・エイ・インストゥルメント・ジャパン | 3B-26 |
| TEGソリューション | 3B-17 |
| 電気印刷研究所 | 3B-04 |
| 電子技研 | 3B-18 |
| 東芝ビジネスエキスパート | 3B-34 |
| トープロテクノサービス | 3B-11 |
| 長瀬産業 | 3B-22 |
| 日邦産業 | 3B-21 |
| ノードソン | 3B-31 |
| ハニー化成 | 3B-07 |
| プラズマイオンアシスト | 3B-29 |
| 三ツ星ベルト | 3B-24 |

アカデミックプラザ

| | |
|-----------------------------|-------|
| 愛媛大学大学院理工学研究科 | 3B-56 |
| 神奈川県立産業技術総合研究所 | 3B-68 |
| 関東学院大学 | 3B-66 |
| 関東学院大学大学院工学研究科 | 3B-67 |
| 九州大学 | 3B-69 |
| 群馬大学 | 3B-63 |
| 群馬大学大学院 理工学府 | 3B-64 |
| 公立諏訪東京理科大学 地域連携研究開発機構 | 3B-62 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 3B-74 |
| 信州大学 | 3B-52 |
| 崇城大学 | 3B-70 |
| 東京工芸大学 | 3B-57 |
| 東京理科大学 | 3B-60 |
| 東京理科大学 | 3B-61 |
| 東北大学 | 3B-71 |
| 徳島大学 | 3B-53 |
| 国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 中山研究室 | 3B-51 |
| 日本大学 内木場・金子研究室 | 3B-58 |
| 日本大学理工学部精密機械工学科 | 3B-59 |
| 北海道大学 | 3B-65 |
| 山形県工業技術センター | 3B-55 |
| 山形大学 | 3B-54 |
| 横浜国立大学 | 3B-72 |
| 横浜国立大学 | 3B-73 |

JISSO PROTEC 2024

| | |
|------|-------|
| アジリル | 4C-05 |
|------|-------|

| | |
|---------------------|-------------|
| アスク | 4C-43 |
| 厚木ミクロ | 4C-42 |
| アユミ工業 | 4C-04 |
| アルファエレクトロニクス | 4C-37 |
| ウイングビジョン | 4C-26 |
| EIZO | 4C-22 |
| エイテックテクトロン | 4C-14 |
| エフピー実業 | 4C-19 |
| 奥田貿易 | 4C-45 |
| 奥原電気 | 4C-32 |
| 化研テック | 4C-16 |
| 加藤精工 | 4C-23 |
| 川崎重工業 | 4C-46 |
| Gichoビジネスコミュニケーションズ | 3A-12 |
| サヤカ | 4C-44 |
| 三桜工業 | 4C-39 |
| 産業分析センター | 4D-44 |
| CKD | 4C-25 |
| JUKI | 4C-52 |
| ジュッツジャパン | 4C-50 |
| 昭立電気工業 | 4C-28 |
| スフィンクス・テクノロジーズ | 4C-35 |
| 千住金属工業 | 4D-44 |
| ダイドー | 4C-05 |
| ダイナトロン | 4C-15/4C-17 |
| 太洋電機産業 | 4C-33 |
| タカヤ | 4C-38 |
| テクノアルファ | 4C-18 |
| 東洋リビング | 4C-21 |
| 日本トムソン | 4C-29 |
| 日本スベリア社 | 4C-02 |
| 日本ミルテック | 4C-48 |
| 日本ロボット工業会 (JARA) | 4C-34 |
| パーミジャパン | 4C-49 |
| ハイウイン | 4C-20 |
| パソコン | 4C-27 |
| 白光 | 4C-47 |
| パナソニック コネクト | 4D-45 |
| FUJI | 5E-63 |
| ブルックス・ジャパン | 4C-41 |
| プロセス・ラボ・ミクロン | 4C-24 |
| PEMTRON | 4C-31 |
| マルコム | 4C-36 |
| 武蔵エンジニアリング | 4C-30 |
| ヤマハ発動機 | 5F-54 |
| ルックス電子 | 4C-40 |

メガバスデバイス展

| | |
|---------|-------|
| 産業タイムズ社 | 3A-16 |
|---------|-------|

WIRE Japan Show 2024

| | |
|---------|-------|
| SWCC | 4C-13 |
| 工業通信 | 3A-27 |
| タツタ電線 | 4C-12 |
| 東富士電機 | 4C-11 |
| 東莞市宝瑞電子 | 4C-06 |

Electronics Component & Unit Show

| | |
|--------|-------|
| アール電子 | 4D-39 |
| 飯田通商 | 4D-43 |
| NNP | 4D-34 |
| 岡本無線電機 | 4D-29 |



| | |
|--------------------|-------|
| グローバルディスプレイ | 4D-32 |
| コアスタッフ | 4D-41 |
| 三共社 | 4D-30 |
| ジュバ | 4D-38 |
| 成電社 | 4D-33 |
| 全国電子部品流通連合会 (JEP) | 4D-42 |
| ツルタ制御機器 | 4D-40 |
| 東亜無線電機 | 4D-37 |
| 東京都電機卸商業協同組合 (TEP) | 4D-42 |
| ノマ電気 | 4D-31 |
| 日川電機 | 4D-35 |
| メロ電気 | 4D-36 |

E-Textile/Wearable

| | |
|-------|-------|
| 織研新聞社 | 3A-08 |
|-------|-------|

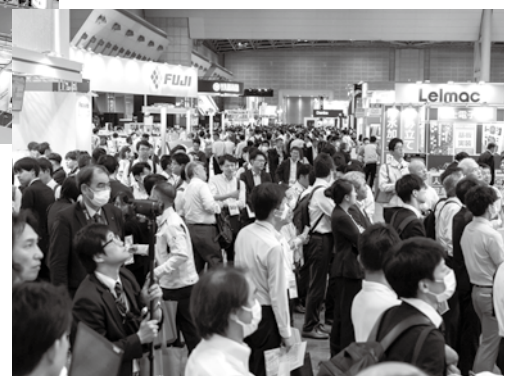
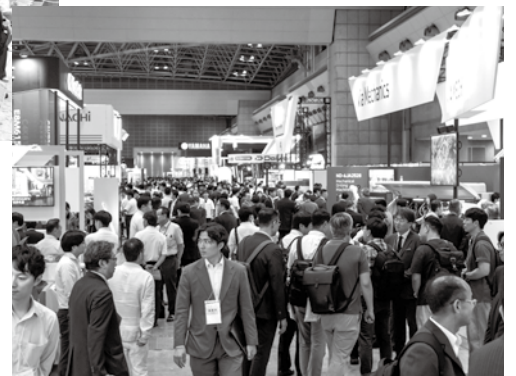
Smart Sensing 2024

| | |
|--------------------------|----------|
| アール・ティー・シー | 5E-50 |
| アイ・アール・システム | 5E-30 |
| アイクリスタル | 5E-55 |
| アイシン高丘 | 5E-03-07 |
| IDTechEx | 5E-73 |
| i-PRO | 5E-62-13 |
| AWL | 5E-62-15 |
| アルプスアルパイン | 5E-62-3 |
| イーガルド | 5E-38 |
| YITOAマイクロテクノロジー | 5E-20 |
| インタープロ | 5E-62-8 |
| AEMtec | 5E-04 |
| SMK | 5E-57 |
| エネルギーハーベスティングコンソーシアム | 5E-03-08 |
| FCLコンポーネント | 5E-62-7 |
| ガゾウ | 5E-33 |
| 金沢大学振動発電研究室 | 5E-03-01 |
| クローネ | 5E-37 |
| グローバルインフォメーション | 5E-48 |
| コーデンシ | 5E-58 |
| コネクテックジャパン | 5E-04 |
| CyberneX | 5E-31 |
| 産業技術総合研究所センシングシステム研究センター | 5E-39 |
| 産業技術総合研究所人間拡張研究センター | 5E-39 |
| ジャパニディスプレイ | 5E-71 |
| SUPWAT | 5E-62-12 |
| スマートストア | 5E-70 |
| 住友金属鉱山 技術本部 技術企画部 | 5E-03-02 |
| ソフトエイジェンシー | 5E-29 |
| ソラコム | 5E-62-2 |
| ダイキンファインテック | 5E-34 |
| 泰興物産 | 5E-62-14 |
| 千歳市 / 公立大学法人 公立千歳科学技術大学 | 5E-72 |
| デザインインターナショナル | 5E-36 |
| デルタツーリング | 5E-62-11 |
| 東海理化電機製作所 | 5E-16 |
| 東京エレクトロニクスデバイス | 5E-36 |
| 東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室 | 5E-59 |
| TOPPAN | 5E-62-5 |
| 内藤電誠町田製作所 | 5E-22 |
| ナルコム | 5E-21 |
| 南陽 | 5E-62-9 |
| 日東電工 | 5E-62-16 |
| 藤倉コンポジット | 5E-62-4 |
| フジトク | 5E-28 |
| ホルトプラン | 5E-19 |
| マイクロモジュールテクノロジー | 5E-61 |

| | |
|--------------------|----------|
| Mouser Electronics | 5E-25 |
| マクセル | 5E-24 |
| マクニカ | 5E-62-6 |
| マルティスーブ | 5E-62-10 |
| 丸文 | 5E-18 |
| 三ツ波 | 5E-35 |
| MODE, Inc. | 5E-62-1 |
| ものづくりドットコム | 5E-17 |
| ヤシマ電気 | 5E-03-03 |
| 横山商会 | 5E-03-04 |
| リンテック | 5E-03-06 |
| レイマック | 5E-49 |
| ロボサビエンス | 5E-56 |

無人化ソリューション展

| | |
|--------------------|-------|
| キャノンITソリューションズ | 5E-53 |
| 慶應義塾大学ハプティクス研究センター | 5E-52 |
| Bocek | 5E-46 |
| ヤマハモーターエンジニアリング | 5E-23 |
| ロボティック普及促進センター | 5E-51 |









電子機器トータルソリューション展 基調講演

有料 VIP/会員無料

●日時：6月12日(水)～14日(金) ●会場：セミナー会場A ●聴講者数：全7セッション 1,069名

| | | |
|----------|---------------------|--|
| 6月12日(水) | 10:30 11:20 |  AIチップインパクトで半導体、実装基板は一大飛躍の時代を迎えた! ～北海道から九州まで「シリコン列島ニッポン」ともいうべき巨大設備投資～ 泉谷 渉 (株)産業タイムズ社 取締役会長 |
| | 11:30 12:20 |  村田製作所の開発動向と車載向けデバイスの展開 岩坪 浩 (株)村田製作所 技術・事業開発本部 取締役 専務執行役員 |

| | | |
|----------|---------------------|---|
| 6月13日(木) | 10:30 11:20 |  スピントロニクス省電力半導体 ～高度情報化社会と低炭素社会への貢献～ 遠藤 哲郎 東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長/教授 東北大学 工学研究科 教授 |
| | 11:30 12:20 |  次世代コンピューティング向けアドバンスド ヘテロジニアスインテグレーションプラットフォーム“ムーアの法則を超えて” 荻谷 隆 日本サムスン(株) Samsung デバイスソリューションズ研究所 Advanced Package Lab. Corporate Vice President / Lab長 |




| | | |
|----------|---------------------|---|
| 6月14日(金) | 10:30 11:20 |  加速する未来への挑戦: Rapidusの半導体後工程戦略 折井 靖光 Rapidus(株) 3Dアセンブリ本部 専務執行役員・3Dアセンブリ本部長 |
| | 11:30 12:20 |  Aiとロボットが融合する未来 ～次世代ロボットビジョン～ 尾形 哲也 早稲田大学 AIロボット研究所 所長 |
| | 12:30 13:20 |  SDV (Software Defined Vehicle) に求められる車載電子システムとは 三田村 健 日立Astemo(株) 電動ビジネス事業部 SDV プラットフォーム統括本部 SVP、統括本部長 |



JISSO PROTEC 特別講演

無料

●日時：6月12日(水)～14日(金) ●会場：セミナー会場G ●聴講者数：全3セッション 509名

| | | |
|----------|---------------------|---|
| 6月12日(水) | |  モバイル機器の最新業界動向と見通し 中根 康夫 みずほ証券(株) エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト |
| 6月13日(木) | 10:30 11:20 |  2030年の電動車の未来像とそこに必要とされるパワー半導体応用システムにおける実装技術要求と将来動向 山本 真義 名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 |
| 6月14日(金) | |  2024年度版 JEITA実装技術ロードマップの紹介 ～実装設備の最新動向～ 前田 憲 JEITA実装技術ロードマップ専門員会 実装設備WG(WG6) 主査/パナソニック コネクト(株) プロセスオートメーション事業部 回路形成プロセス開発総括部 印刷技術開発部 主幹技師 |



JIEP最先端実装技術シンポジウム

【有料】

●日 時：6月12日(水)～14日(金)

●会場：最先端実装技術シンポジウム A会場・B会場

●聴講者数：3,206名

| A会場 | | B会場 | |
|-------------|--|---|--|
| | 12A-1 グリーンデバイスの未来戦略 座長：土門 孝彰、西田 秀行 | 12B-1 5G/6G向け高周波対応材料開発動向 座長：松本 博文、高野 希 | |
| 10:15-11:05 | 12A1-1 大口径ダイヤモンド基板のヘテロエピタキシャル成長とデバイス応用 金 聖祐 Orbray(株) Orbrayダイヤモンド研究所 所長 | 12B1-1 5G/6Gに向けた低伝送損失基板材料の技術開発動向 日高 圭芸 (株)レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター 積層材料開発部 チームリーダー | |
| 11:05-11:55 | 12A1-2 究極の半導体デバイス! ダイヤモンドパワー半導体の現状と課題 嘉数 誠 佐賀大学 理工学部理工学科電気電子工学部門 教授 | 12B1-2 5G/6Gを見据えた高速高周波用プリント基板用材料の開発動向 森野 正行 AGC(株) 化学品カンパニー 機能化学品事業本部 応用商品開発部 用途開発グループ グループリーダー | |
| 11:55-12:45 | 12A1-3 世の中に最大限貢献できるGaNデバイスとその取組みの紹介 山口 雄平 ローム(株) LSI事業本部 パワーステージ商品開発部 統括課長 | 12B1-3 高周波プリント配線板、サブストレートを支える低誘電材料、平滑導体との高信頼性接合技術 八甫谷 明彦 (株)ダイセル スマートSBU グループリーダー | |
| | 12A-2 パワーモジュールの最新技術と今後の展開 座長：渡邊裕彦、和嶋元世 | 12B-2 光電融合技術の新潮流と最新動向 座長：谷 元昭、中條 徳男 | |
| 13:30-14:20 | 12A2-1 SiC/GaNパワーデバイスの最新動向 岩室 憲幸 筑波大学 数理工学系 教授 | 12B2-1 AIクラウドデータセンタ応用光インタコネクトの最新動向 高井 厚志 LiAhead Independent Consultant | |
| 14:20-15:10 | 12A2-2 パワーデバイス向け電子部品の課題と動向 梶田 栄 NPO法人サーキットネットワーク 理事長 | 12B2-2 Co-Packaged Opticsに向けた実装技術 那須 秀行 古河電気工業(株) フォトニクス研究所光電融合技術開発部 部長/主幹研究員 | |
| 15:10-16:00 | 12A2-3 パワーモジュールの最新技術と今後の展開「車載用パワー半導体モジュールのパッケージ技術」 両角 朗 富士電機(株) 半導体事業本部 開発統括部 パッケージ開発部 要素技術一課 主査 | 12B2-3 PCI express光伝送の動向とそれを実現する光電集積モジュール 赤星 知幸 京セラ(株) 先進マテリアルデバイス研究所 | |
| | 13A-1 自動運転に向けた車載機器の動向と実装技術 座長：三宅 敏広、齊藤 雅之 | 13B-1 GenerativeAI (Chat GPT等)と半導体の先端技術(ガラス基板動向含む) 座長：土門 孝彰、西田 秀行 | |
| 10:15-11:05 | 13A1-1 自動運転シャトルのしくみと開発動向 中嶋 太郎 (株)マクニカ スマートシティ&モビリティ事業部スマートモビリティ事業推進部 第2課 リーダー | 13B1-1 2024年から始まる異次元の半導体成長シナリオ 南川 明 インフォマインテリジェンス(同) コンサルティング シニアコンサルティングディレクター | |
| 11:05-11:55 | 13A1-2 手のひらサイズの長距離LiDARと点群処理ミドルウェア 崔 昭秀 (株)東芝 NEXTビジネス開発部 新規事業推進室 | 13B1-2 生成AIにおける半導体パッケージングの標準化について 吉田 浩秀 大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所 特任研究員/IEC SC47D国際幹事 | |
| 11:55-12:45 | 13A1-3 車載プリント配線板の高密度、高放熱、高速伝送に向けた基板開発の取り組み 戸田 光昭 (株)メイコー 技術マーケティング企画室 室長 | 13B1-3 生成AI用先端半導体パッケージングの技術動向 宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ(株) 代表取締役 | |
| | 13A-2 EV車載機器の動向と実装技術 座長：三宅 敏広、池田 浩昭 | 13B-2 メタバース時代のデバイス・半導体PKG実装技術動向 座長：土門 孝彰、西田 秀行 | |
| 13:30-14:20 | 13A2-1 経済安全保障の車載電池を巡るグローバル競争と日本の課題 佐藤 登 名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授/エスベック(株) 役員室 上席顧問/イリソ電子工業(株) 役員室 社外取締役 | 13B2-1 XRが牽引するマイクロディスプレイ動向 澤登 美英子 (株)産業タイムズ社 編集部 主任 | |
| 14:20-15:10 | 13A2-2 車載電気機器における材料と実装技術の高度融合技術の紹介と次世代自動車に求められるパワー半導体実装技術～熱マネジメントの視点から・日産アリアやテスラの事例を含めて～ 山本 真義 名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 | 13B2-2 先端プロセッサとPKG市場の動向 山本 義継 みずほ証券 エクイティ調査部 シニアアナリスト | |
| 15:10-16:00 | 13A2-3 インバータの小型・高性能化に貢献する三菱電機の自動車用パワーモジュール 飯塚 新 三菱電機(株) パワーデバイス製作所パワーデバイス第一部 自動車製品設計第二課 | 13B2-3 生成AIモデルサイズ拡大に対応するチップレットパッケージの挑戦課題 西尾 俊彦 (株)SBRテクノロジー 代表取締役 | |
| | 14A-1 半導体の最新動向、次世代半導体とは? 座長：土門 孝彰、西田 秀行 | 14B-1 高密度・高機能化を支える先端配線板技術 座長：谷 元昭、佐藤 牧子 | |
| 10:15-11:05 | 14A1-1 半導体製造装置の市場動向 渡部 潔 (一社)日本半導体製造装置協会 専務理事 | 14B1-1 ガラス基板の開発動向とフォトニクス分野への応用 酒井 泰治 FICT(株) テクノジ本部先行技術開発部 プロジェクト部長 | |
| 11:05-11:55 | 14A1-2 半導体業界の明るい展望 和田木 哲哉 モルガン・スタンレー MUFJ証券(株) 調査統括本部 マネージング ディレクター | 14B1-2 Weak-Micro Viaを解決する高接続信頼性の無電解銅めっき技術 北原 悠平 奥野製薬工業(株) 総合技術研究部 第三研究室 室長 | |
| 11:55-12:45 | 14A1-3 半導体技術の新たな転換点ー2nm世代半導体デバイス・プロセス技術 小林 正治 Rapidus シリコン技術本部 デバイス技術部ディレクター/東京大学 d.lab 准教授 | 14B1-3 次世代BTレジン積層材料の技術開発動向 伊藤 環 三菱ガス化学(株) 機能化学品事業部門企画開発部電子材料グループ 主査 | |
| | 14A-2 チップレット集積の現状と課題 座長：西田 秀行、齊藤 雅之 | 14B-2 半導体微細加工/新構造導電ペーストでウェアラブルデバイスが変わる 座長：本多 進、猪川 幸司 | |
| 13:30-14:20 | 14A2-1 チップレット集積技術の最新動向 栗田 洋一郎 東京工業大学 産業科学技術創成研究院 特任教授 | 14B2-1 FOWLPと三次元実装技術で創るiFHE(インモールド・フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス) 福島 誉史 東北大学 大学院工学研究科・機械機能創成専攻 准教授 | |
| 14:20-15:10 | 14A2-2 TSMCの3DIC技術と日本のエコシステムの融合で世界のイノベーションを生み出す 安原 隆太郎 TSMCジャパン 3DIC研究開発センター(株) プロセスインタラクション部門 プリンシパルエンジニア | 14B2-2 MEMS製造の最新技術とウェアラブルデバイスへの応用 金尾 寛人 SPPテクノロジーズ(株) 製造部兼生産管理兼マーケティング 次長 | |
| 15:10-16:00 | 14A2-3 ウェーハ・トゥ・ウェーハ、ダイ・トゥ・ウェーハ・ハイブリッド接合による集積技術 山本 宏 イーヴィグループジャパン(株) 代表取締役 | 14B2-3 ウェアラブルデバイス応用に向けたフレキシブル・ストレッチャブル配線材料の開発状況 井上 雅博 群馬大学大学院理工学府 知能機械創製部門 准教授 | |

6月12日(水)

6月13日(木)

6月14日(金)



出展者セミナー 無料

1) 出展者 (NPI) プレゼンテーション

●日 時：6月12日(水)～14日(金) ●会 場：セミナー会場D ●聴講者数：1,314名

●発表出展会社

(50音順)

(株)IDAJ / アトテックジャパン(株) / イー・エス・アイ・ジャパン(株) / 上村工業(株) / エステック(株) / LPKF Laser & Electronics(株) / (株)オーク製作所 / 奥野製薬工業(株) / オックスフォード・インストゥルメント(株) / (株)オンテック / 三桜工業(株) / (株)三共社 / 澁谷工業(株) / シュマルツ(株) / (株)SCREEN PEソリューションズ / ダイナトロン(株) / ティー・エイ・インストゥルメント・ジャパン(株) / テクノアルファ(株) / 東芝情報システム(株) / 東洋アルミニウム(株) / TOPPAN(株) / (株)内藤電誠町田製作所 / Hanel Production and Import-Export Joint Stock Company / (株)パイ・テクノロジー / (株)ブルックスジャパン / マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン(株) / 武蔵エンジニアリング(株) / ユニオンツール(株) / (株)ワンダーフューチャーコーポレーション

2) 第20回JPCA賞(アワード)受賞者

この度、JPCA賞(アワード)選考委員会にて、厳正なる審査の上、第20回JPCA賞(アワード)受賞企業が下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。JPCA賞(アワード)は、参加企業の中から、応募のあった発表内容の『独創性(独自性・オリジナリティ)』、『産業界での発展性・将来性』、『信頼性』、『時世の適合性』を審査基準として、学术界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々と構成するJPCA賞(アワード)選考委員会によって厳正な審議を行い、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術への表彰制度として2005年より実施しています。

【表彰式】セミナー会場C 日時：6月12日(水)16:40～16:55

(50音順)

| JPCA賞 | |
|---|---------------------------|
| ■高速通信基板向け熱硬化性低誘電樹脂の開発 | JSR(株) |
| ■パワー半導体向け高放熱絶縁材料 | 太陽インキ製造(株) |
| ■JTAG検査とフライングプローブテストを組み合わせたハイブリッド検査システム | タカヤ(株) / アンドールシステムサポート(株) |
| ■次世代低反りBTLレジソ積層板材料 HL832RS/GHPL-830RS | 三菱ガス化学(株) |

| JPCA奨励賞 | |
|--|-----------------------|
| ■高密度貫通スルーホールコア基板向け電解銅めっき浴 | 上村工業(株) |
| ■パワーデバイス向けリードフレーム用 粒状銅めっき添加剤 トップクラスターAR | 奥野製薬工業(株) |
| ■低誘電正接を特長とする真球状非晶質シリカ Sciqas®-LTシリーズ | 堺化学工業(株) |
| ■IHリフロー技術による電子基板製造の社会的課題の解決(SDGs・PFAS規制対応) | (株)ワンダーフューチャーコーポレーション |



3) 3D-MIDパピリオンセミナー

●日 時：6月12日(水)～14日(金) ●会 場：セミナー会場E ●聴講者数：104名

●発表出展会社：(地独)岩手県工業技術センター / 三共化成(株) / (株)図研 / (一社)電子情報技術産業協会(JEITA) / 日本MID協会 / (株)ワンダーフューチャーコーポレーション (50音順)

4) PROTECセミナー

●日 時：6月12日(水)～14日(金) ●会 場：セミナー会場H ●聴講者数：668名

●発表出展会社：JUKI(株) / 千住金属工業(株) / パナソニックコネクタ(株) / (株)FUJI / 武蔵エンジニアリング(株) / ヤマハ発動機(株) (50音順)



出展者セミナー 無料

5) アカデミックプラザ

●日 時：6月12日(水)～14日(金) ●会 場：セミナー会場E ●聴講者数：718名

●発表出展大学・研究機関等一覧

(50音順)

愛媛大学 / 大阪電気通信大学大学院 / 関東学院大学大学院 工学研究科 / 関東学院大学大学院 工学研究科 小岩研究室 / 群馬大学大学院 理工学府 / 信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室 / 崇城大学 工学部 機械工学科 / (株)電子技研 / 東京工芸大学 / 東京工芸大学大学院 / 東京工芸大学大学院 工学研究科 / 東京理科大学 / 東京理科大学 創域理工学部 電気電子情報工学科 / 同志社大学理工学研究科 機械専攻生産システムデザイン研究室 / 同志社大学大学院生 / 東北大学 / 徳島大学大学院 創成科学研究科 / 長野工業高等専門学校 / 日本大学 マイクロデザイン研究室 / 日本大学理工学研究科 精密機械工学専攻 / 北海道大学大学院 工学研究院 米澤研究室 / 山口東京理科大学 / 横浜国立大学

6) 2024 アカデミックプラザ受賞者

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP展示会委員会(越地委員長：東京工芸大学 工学部 総合工学系 電気電子コース、大学院 工学研究科 電子情報工学専攻、基礎教育研究センター 教授)で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定いたしました。

【表彰式】セミナー会場E 日時：6月12日(水)16:40～17:00

| | |
|---------------------------------------|---|
| ■ ハイブリッド接合における接合強度と界面評価 | 横浜国立大学 |
| ■ 圧搾ガス駆動による内視鏡接続型MEMSマイクロロボットの開発 | 日本大学/マイクロデザイン研究室 |
| ■ 電子機器の温度上昇を抑制する超小型MEMS ベーパーチャンバーの開発 | 日本大学/マイクロデザイン研究室 |
| ■ 待機状態ICの入力配線検査を行うバウンダリスキャン用コントローラの試作 | 徳島大学大学院創成科学研究科 徳島大学大学院社会産業理工学研究部 放送大学徳島学習センター |
| ■ ITO 透明導電膜を利用したコプレーナ線路の伝送特性の検討 | 東京工芸大学 工学部 |

7) Electronics Component & Unit Show 出展者セミナー

●日 時：6月13日(木) ●会 場：セミナー会場F

●発表出展会社：東亜無線電機㈱



Smart Sensing / 無人化ソリューション展 / Edge Computing セミナー

無料

●日 時：6月12日(水)～14日(金) ●会 場：セミナー会場F ●聴講者数：750名

Keynote Speech

| | | |
|----------|-------------|--|
| 6月12日(水) | 10:15-11:05 | Pudu Roboticsからの省力化ソリューションご提案 張涛 Pudu Robotics CEO |
| | 11:35-12:25 | 変える力とつなぐ力でIoT実装に革命を ～チップレット及びセンサー最新市場動向と開発事例～ 平田 勝則 コネクテックジャパン(株) 代表取締役 会長 |
| 6月13日(木) | 10:15-11:05 | インターバース技術によるバーチャルエコノミーの拡大 持丸 正明 (国研)産業技術総合研究所 人間拡張研究センター フェロー 兼 研究センター長 |
| | 11:35-12:25 | 振動発電『V-GENERATOR』のサプライチェーンについて 北 翔太 金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 特任助教 泉 聖志 住友金属鉱山(株) 峰 佳祐 (株)横山商会 櫻井 広樹 ヤシマ電気(株) |
| | 13:45-14:35 | 理想をカタチにするテクノロジー ～AI向け最先端デバイスの紹介 廣田 大輔 ウルト・エレクトロニクス・ジャパン(株) FAE・フィールドアプリケーション エンジニア 森野 航一 日清紡マイクロデバイス(株) 営業本部 営業統括部 FAE課 専門課長 柴田 尚久 日本ケミコン(株) ソリューション開発部 専門マネージャ 西川 裕 トレックス・セミコンダクター(株) マーケティング部 グローバルマーケティンググループ リーダー |
| 6月14日(金) | 11:35-12:25 | 生成AIで激変するセンサーの価値 上野 聡志 MODE, Inc. Vice President of Business |

パネルディスカッション

| | | |
|----------|-------------|--|
| 6月14日(金) | 10:15-11:05 | においセンサの未来展望 ～においセンサで社会は変わる～ モデレーター 吉川 元起 国立研究開発法人物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 グループリーダー パネリスト 今村 岳 (株)Qception 代表取締役 喜多 純一 (株)におい科学研究所 代表 黒木 俊一郎 (株)アロマビット 代表取締役兼CEO |
|----------|-------------|--|

企業プレゼンテーション

| | | |
|----------|-------------|--|
| 6月12日(水) | 13:45-14:25 | 多品種変量時代にはビジネスモデルで戦う”半導体後工程に付加価値チャンスあり” 安藤 守 コネクテックジャパン(株) 取締役 常務執行役員 |
| | 14:45-15:25 | 極限環境分野においていかに収益化を目指すか(ハイブリッドデュアルユース/ダブルインカム) 民生技術の発掘・育成(安全保障技術研究推進制度と先進技術の橋渡し研究) 小林 賢一 NPO法人ロボティック普及促進センター 理事長 / (株)ロボットメディア 代表取締役 南 亜樹 防衛装備庁 技術戦略部 技術連携推進官 |
| 6月13日(木) | 12:45-13:25 | センシングアプリケーション用赤外線LED (IR LEDs for Sensing Applications) Murali Kumar Luminus Devices (presented by 丸文) Non-Visible Products Business Line Director |
| 6月14日(金) | 12:45-13:25 | DX推進を担うセンサー技術活用について ～プロセス改善、自動化、省人化の礎～ 鈴木 崇司 ものづくりドットコム エキスパート会員 神上コーポレーション(株) |
| | 13:45-14:25 | センシング向けIoT無線通信デバイスの紹介 ～セルラー/LPWA/サブギガ/2.4GHz XBee + Digi Remote Managerで遠隔管理～ 江川 将峰 デジインターナショナル(株) 代表取締役社長 |



主催者セミナー

●ダントツものづくりセミナー 無料

●日 時：6月12日(水)～14(金) ●会 場：セミナー会場C ●聴講者数：267名

| 6月12日(水) | | 6月13日(木) | | 6月14日(金) | |
|---------------------|---|-------------------------|---|---------------------|--|
| 生産性向上ものづくり特別セッション | | グローバルサプライチェーンと品質管理セッション | | TOC / 管理会計セッション | |
| 13:00 ↓ 13:45 | 0612TK 【特別基調講演】生産性向上の時代における地域スクール/JPCAものづくりアカデミーの役割 藤本 隆宏 東京大学名誉教授 / 早稲田大学教授 | 13:00 ↓ 14:00 | 0613T3 【特別講演3】強靱なものづくりサプライチェーンの構築 新宅 純二郎 東京大学名誉教授 / 明治大学教授 | 13:00 ↓ 13:45 | 0614T4 【特別講演4】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO |
| 13:45 ↓ 14:30 | 0612TK 【特別基調講演】賃金上昇、人手不足、原材料高騰の中での電子回路業界活性化は生産性向上しかない！ 藤本 隆宏 東京大学名誉教授 / 早稲田大学教授 | 14:05 ↓ 15:05 | 0613S1 JPCAものづくり大賞 / 準大賞受賞(2022年度)改善取り組み事例報告3件 大賞受賞 FICT(株)長野本社製造本部 車載向け基板の少人化検査ラインの構築 準大賞受賞 (株)メイコー福島工場 外周仕上げライン生産性改善 準大賞受賞 太陽インキ製造(株)埼玉工場 埼玉工場の作業の標準化 | 13:45 ↓ 14:30 | 0614T5 【特別講演5】月曜日が楽しみな会社にしよう！～全体最適のマネジメント理論TOCとは～ 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO |
| 14:35 ↓ 15:20 | 0612T1 【特別講演1】トヨタ式現場管理 田中 正知 トヨタ自動車OB (ものづくり大学名誉教授/J-J-コスト研究所代表) | 15:10 ↓ 15:50 | 0613K1 【基調講演】経営効果がわかる、トヨタ生産システム「業界の生産性向上実績」 山本 治彦 JPCAものづくりアカデミー校長 / E-ESMAP研究会特別顧問 | 14:35 ↓ 15:20 | 0614T6 【特別講演6】電子回路ものづくり企業の「現場改善」について『お金の良い流れ』から考える 柊 紫乃 愛知工業大学 経営学部経営学科 教授 |
| 15:20 ↓ 16:05 | 0612T2 【特別講演2】現場改善のJコスト理論による強化策(ROA) 田中 正知 トヨタ自動車OB (ものづくり大学名誉教授/J-J-コスト研究所代表) | | | 15:20 ↓ 16:05 | 0614T7 【特別講演7】経営者は何を管理すれば現場改善効果を見える化できるのか『現場改善会計(GKC)』 柊 紫乃 愛知工業大学 経営学部経営学科 教授 |

●主催者セミナー(出展者講演枠) 無料

●日 時：6月12日(水)・14日(金) ●会 場：セミナー会場C ●聴講者数：45名

| | | |
|----------|-------------|---|
| 6月12日(水) | 10:30-11:15 | 最先端PKGサブストレートに対応し、更に環境に配慮しためっきプロセス・設備のご紹介 ドン・ジャン アトテックジャパン(株) |
| 6月14日(金) | 10:30-11:15 | 製造業における試作 / 量産 / 評価データを有効活用するDX戦略の1つとしてのプロセスインフォマティクス活用 高石 将輝 アイクリスタル(株) |

●ぷりんとはんじゅくセミナー 無料

●日 時：6月12日(水)・14日(金) ●会 場：セミナー会場B ●聴講者数：410名

| | | |
|----------|-------------|--|
| 6月12日(水) | 13:00-14:00 | プリント配線板全般の基礎“ぷりんとはんじゅくI”をもとに解説 榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役 |
| | 14:15-15:15 | プリント配線板設計の基礎“ぷりんとはんじゅくII”をもとに解説 田中 弘文 |
| | 15:30-16:30 | フレキシブル配線板の基礎“ぷりんとはんじゅくVII”をもとに解説 宮崎 博明 |
| 6月14日(金) | 12:30-13:30 | 実装の基礎“ぷりんとはんじゅくV”をもとに解説 榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役 |
| | 13:45-14:45 | 品質管理の基礎 安井 博文 安井事務所 PWBコンサルタント |



主催者セミナー

●製品化学物質管理セミナー 無料

●日 時：6月13日(木) ●会 場：セミナー会場B ●聴講者数：83名

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------|--|
| 6月13日(木) | 15:00-16:15 | PFAS 規制化の動向と電子機器業界の対応 | 菅原 高嶺 日本フルオロケミカルプロダクト協議会 AGC(株) 化学品カンパニー |
| | | | |

●製品安全セミナー 無料

●日 時：6月13日(木) ●会 場：セミナー会場B ●聴講者数：26名

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 6月13日(木) | 13:30-14:30 | プリント配線板のUL796評価と背景を解説 | 榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役 |
| | | | |

●JPCAプリント配線板技術ロードマップセミナー 無料

●日 時：6月12日(水) ●会 場：セミナー会場I ●聴講者数：232名

| | | | |
|----------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 6月12日(水) | 13:30-14:30 | プリント配線板技術ロードマップ解説とガラス・サブストレート技術トレンド | 宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ(株) 代表取締役 |
| | | | |

●PWBコンサルタントスキルアップセミナー 無料

●日 時：6月14日(金) ●会 場：セミナー会場I ●聴講者数：36名

| | | | |
|----------|-------------|--|--|
| 6月14日(金) | 15:00~16:45 | 対象 PWBコンサルタント、PWBインストラクタ1級・準1級資格保有者の方のみ | |
| | | | |

●²⁰²⁴半導体・オブ・ザ・イヤー2024

●日 時：6月12日(水) ●会 場：セミナー会場G

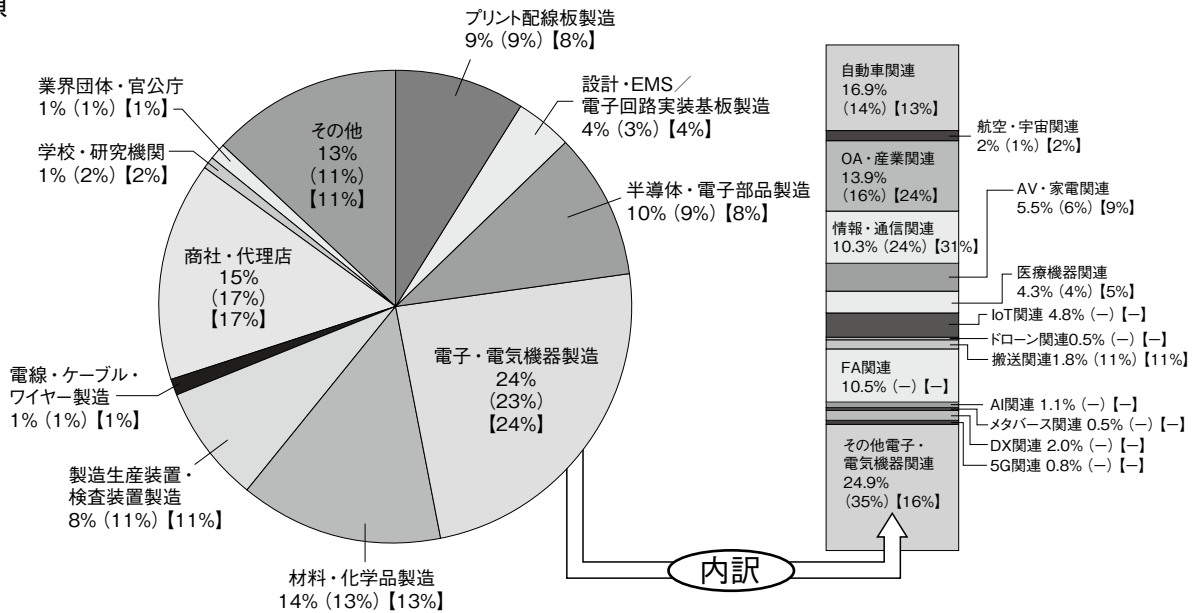
半導体オブ・ザ・イヤー 2024は、2023年4月～2024年3月の間に発表された新製品・新技術の中から産業タイムズ社にて厳正に選出いたしました。

| 【半導体デバイス部門】 | | |
|--------------|------------------------|--|
| グランプリ | NVIDIA | NVIDIA Blackwell プラットフォーム |
| 優秀賞 | Power Diamond Systems | ダイヤモンド半導体における世界最高ドレイン電流を実現したMOSFETの開発 |
| | 東北大学 | STT-MRAM 素子の極限微細化技術 |
| 【半導体製造装置部門】 | | |
| グランプリ | TOWA | 生成AI向け半導体の生産に最適なモールドング装置「YPM1250-EPQ」 |
| 優秀賞 | レーザーテック | アクティビックEUV/パターンマスク欠陥検査装置「ACTIS A300」シリーズ |
| | 横浜国立大学、ディスコ、東レエンジニアリング | 新たなチップ集積手法によるDie-to-Wafer ハイブリッド接合技術の開発 |
| 【半導体用電子材料部門】 | | |
| グランプリ | 旭化成、Crystal IS | 4インチ窒化アルミニウム (AlN) 単結晶基板 |
| 優秀賞 | DIC | 環境配慮型の高性能PFASフリー界面活性剤「MEGAFACE EFSシリーズ」を開発 |
| | TOPPAN | 次世代半導体向けコアレス有機インターポーザー |

全展示会実績

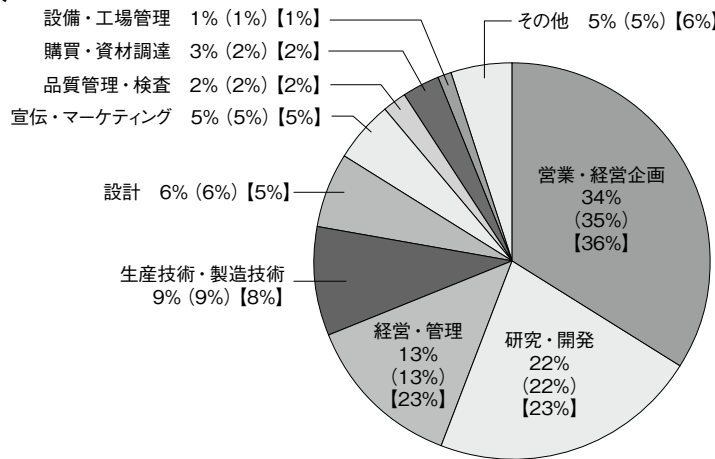
①来場者の業種分類

() 2023 年展示会数値
【 】2022 年展示会数値



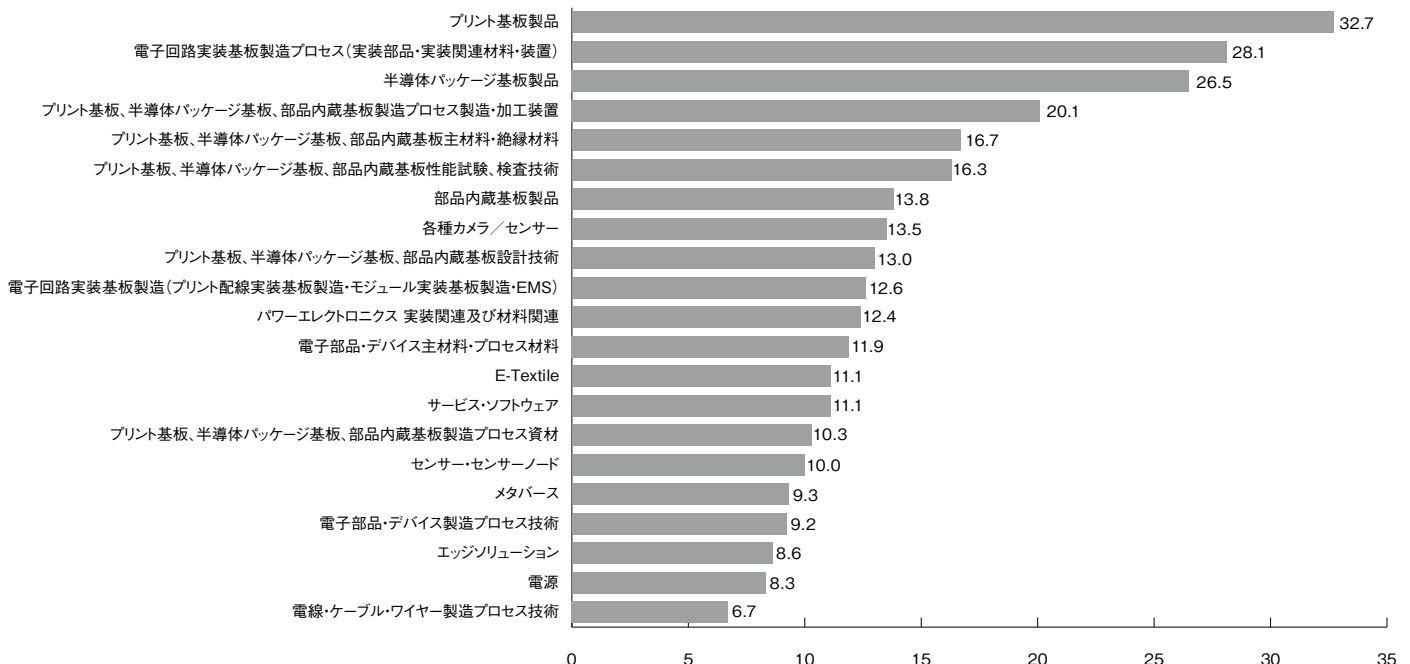
②来場者の職種分類

() 2023 年展示会数値
【 】2022 年展示会数値



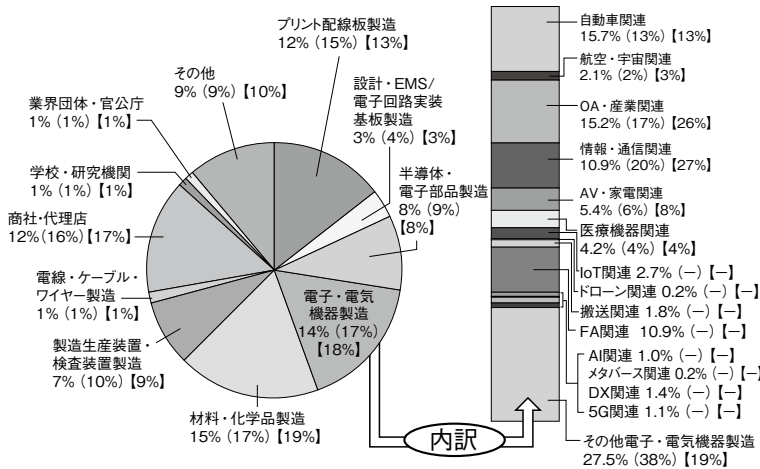
本展は総合展示会のため電子機器に関する幅広い業種の方々に来場いただき、なかでも電子・電気機器製造の方が多い。特に電子・電気機器製造の中でも『その他』の方が前回よりも多く、より来場者層の幅が広がっていることが見受けられる。
また、製品分類においては、プリント配線板製品、半導体パッケージング製品への関心度が高い。

③来場者が関心のある製品分類 ※複数回答

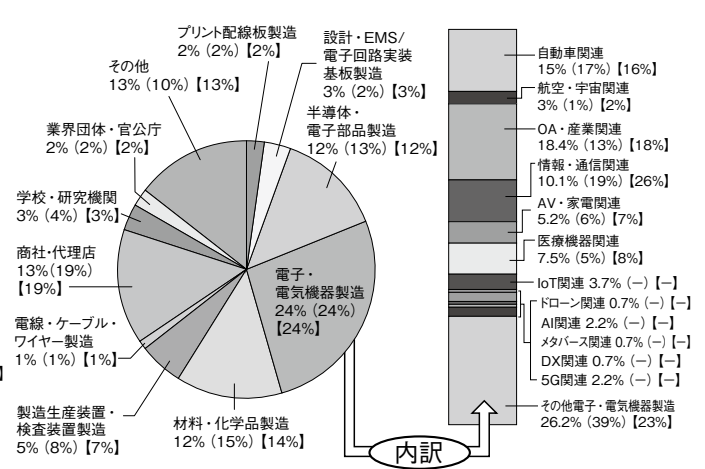


来場者分析

JPCA Show 2024 () 2023 年展示会数値
 [] 2022 年展示会数値

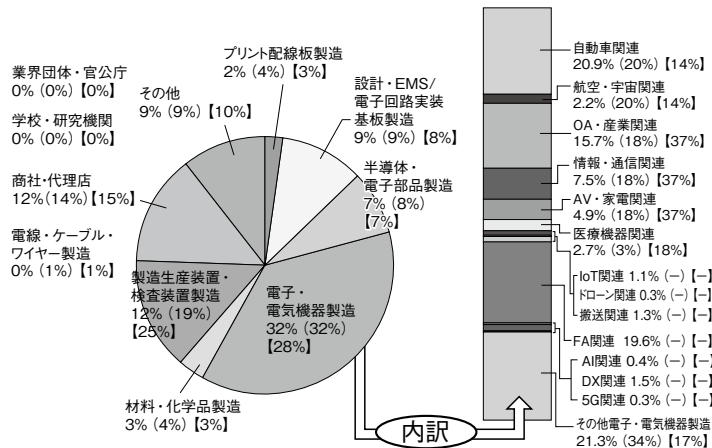


2024 マイクロエレクトロニクスショー () 2023 年展示会数値
 [] 2022 年展示会数値



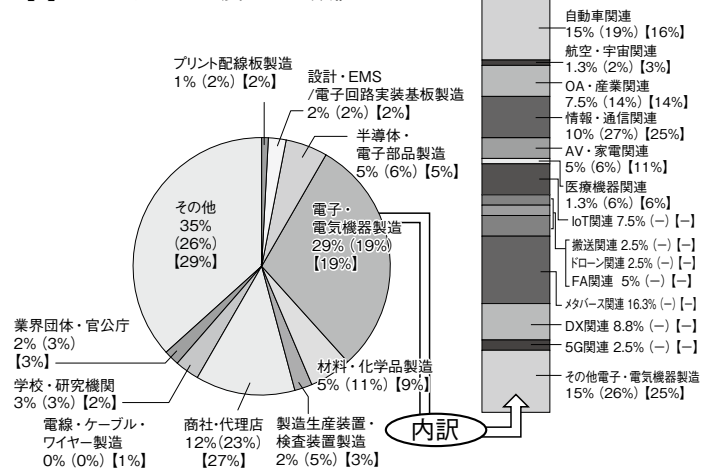
JISSO PROTEC 2024

() 2023 年展示会数値
 [] 2022 年展示会数値

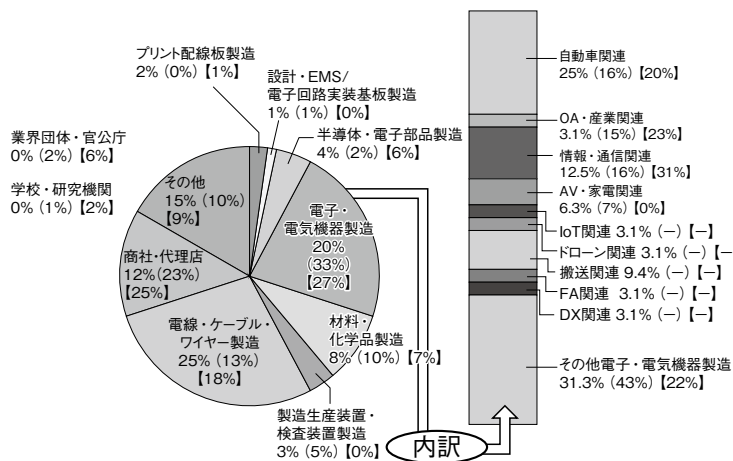


メタバースデバイス展 (旧SDGsデバイス展)

() SDGs デバイス展 2023 数値
 [] SDGs デバイス展 2022 数値

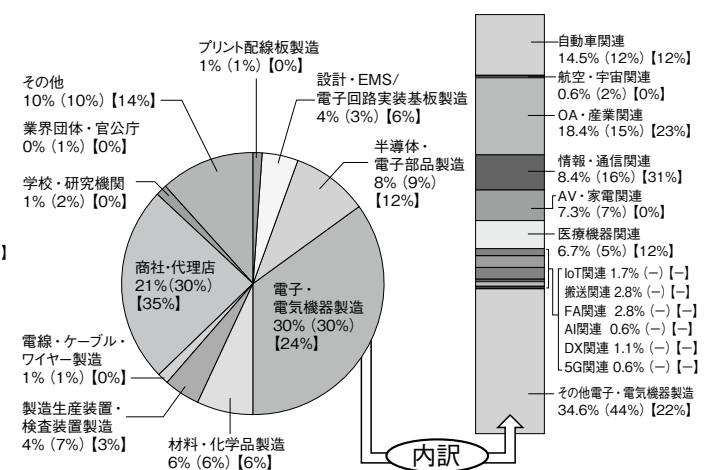


WIRE Japan Show 2024 () 2023 年展示会数値
 [] 2022 年展示会数値



Electronics Component & Unit Show

() 2023 年展示会数値
 [] 2022 年展示会数値
 ※上記数値はJEP/TEP Show より

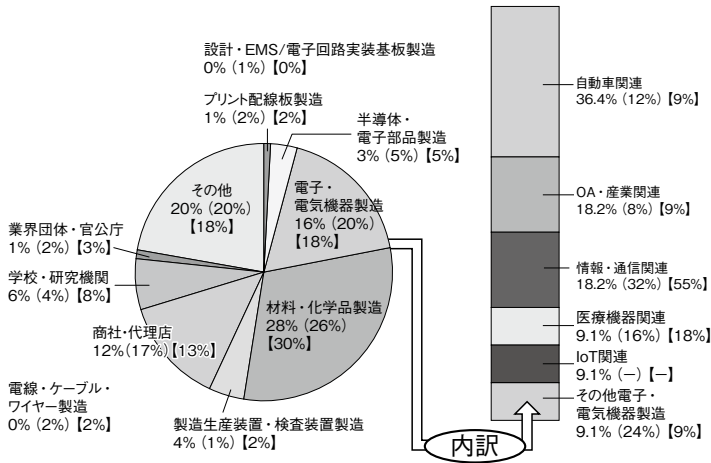




来場者分析

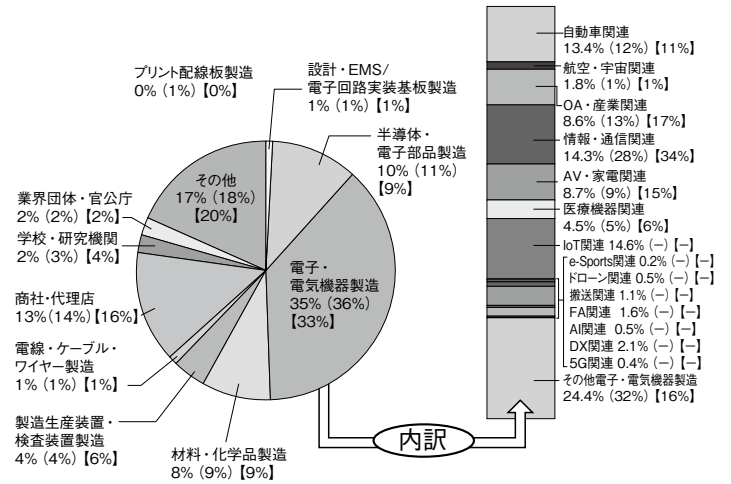
E-Textile/Wearable

() 2023 年展示会数値
【 】2022 年展示会数値



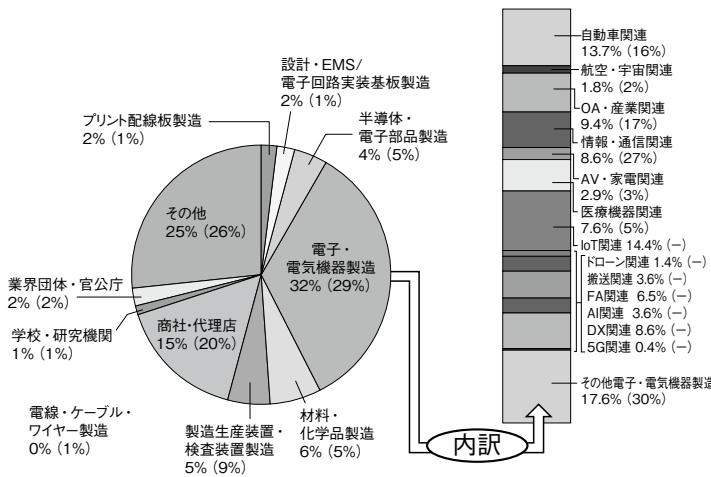
Smart Sensing 2024

() 2023 年展示会数値
【 】2022 年展示会数値



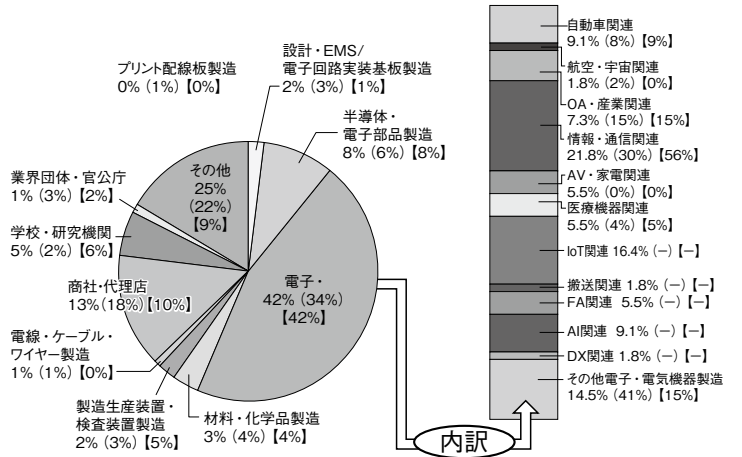
無人化ソリューション展

() 2023 年展示会数値
※ 2023 年より開催



Edge Computing

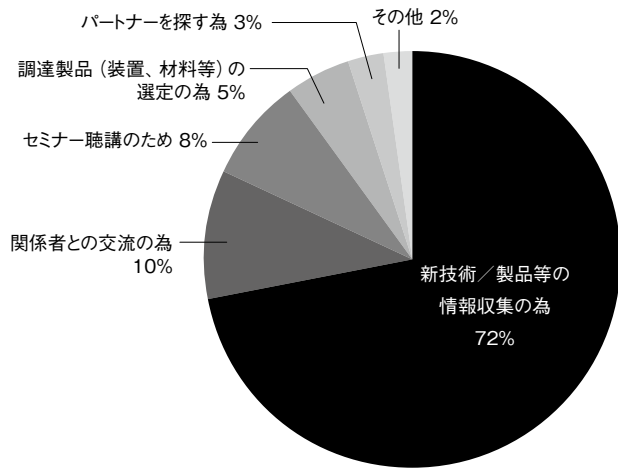
() 2023 年展示会数値
【 】2022 年展示会数値



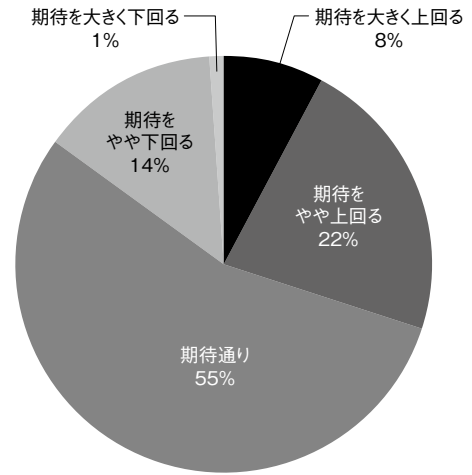


来場者アンケート

① 来場目的

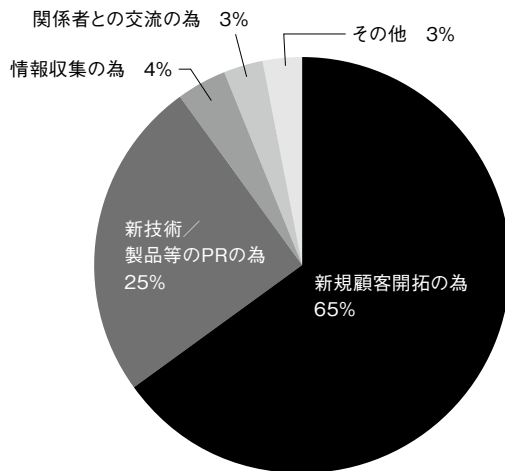


② 来場成果

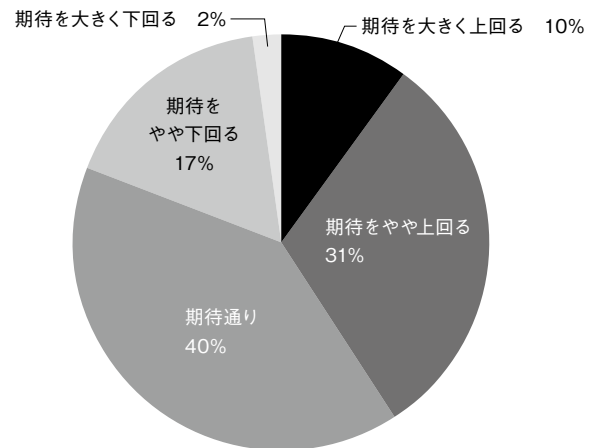


出展者アンケート

① 出展目的



② 出展成果





2024年展示会主催・運営委員会 委員

2024展示会運営委員会

- 委員長 高井 健郎
JPCA 副会長／太陽ホールディングス(株)
- 副委員長 小島 正紀
JPCA 副会長／ニッカン工業(株)
- 委員 猪川 幸司
JIEP 展示会運営委員会委員長／日本シイエムケイ(株)
- 委員 太田 裕之
JISSO PROTEC 2024 運営委員会 委員長／
ヤマハ発動機(株)
- 委員 泉谷 渉
メタバースデバイス展共催会社会長／
(株)産業タイムズ社(電子デバイス産業新聞)
- 委員 井上 政基
WIRE Japan Show 共催会社社長／(株)工業通信(電線新聞)
- 委員 長谷川 裕久
Smart Sensing 共催会社代表／
(株)JTBコミュニケーションデザイン
- 委員 川鍋 季明
Electronics Component & Unit Show 共催団体代表／
(株)三共社
- 委員 藤浦 修一
E-Textile/Wearable 共催会社代表／(株)織研新聞社

展示会企画委員会

- 委員長 石川 雅昭 JPCA 理事／
超高効率電子回路生産システム研究会
- 副委員長 小島 正紀 JPCA 副会長／ニッカン工業(株)
- 副委員長 ジュリアン・ベイショア JPCA 理事／
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・
ジャパン(株)
- 委員 猪川 幸司 JIEP 展示会運営委員会委員長／
日本シイエムケイ(株)
- 委員 太田 裕之 JISSO PROTEC 2024 運営委員会 委員長／
ヤマハ発動機(株)
- 委員 泉谷 渉 メタバースデバイス展共催会社会長／
(株)産業タイムズ社(電子デバイス産業新聞)
- 委員 井上 政基 WIRE Japan Show 共催会社社長／
(株)工業通信(電線新聞)
- 委員 長谷川 裕久 Smart Sensing 共催会社代表／
(株)JTBコミュニケーションデザイン
- 委員 鶴田 哲司 Electronics Component & Unit Show 代表／
ツルタ制御機器(株)
- 委員 藤浦 修一 E-Textile/Wearable 共催会社代表／
(株)織研新聞社

JIEP 展示会運営委員会

- 委員長 猪川 幸司 日本シイエムケイ(株)
- 副委員長 越地 福朗 東京工芸大学
- 渡部 美子 (一社)日本電子回路工業会
- 佐藤 牧子 ナミックス(株)
- 委員 松本 博文 フレックスリンクテクノロジー(株)
- 土門 孝彰 秋田銀行
- 三宅 敏広 (株)デンソー
- 高野 希 日立化成(株)
- 加藤 義尚 福岡大学
- 齊藤 雅之 元(株)東芝
- 西田 秀行 ニシダエレクトロニクス実装技術支援
- 池田 浩昭 日本航空電子工業(株)
- 中條 徳男 (株)日立製作所
- 本多 進 C-NET
- 和嶋 元世 C-NET
- 渡邊 裕彦 富士電機(株)
- 谷 元昭 T2リサーチ
- 伊藤 寿浩 東京大学
- 内木場文男 日本大学
- 小岩 一郎 関東学院大学
- 澤田 廉士 Palmens(株)
- 白石 洋一 群馬大学
- 金谷 春一 九州大学
- 加藤 義尚 福岡大学

実装プロセステクノロジー展運営委員会

- 委員長 太田 裕之 ヤマハ発動機(株)
- 副委員長 富士原 寛 (一社)日本ロボット工業会
- 委員 秋山 昭博 パナソニックコネクタ(株)
- 曾我 信之 (株)FUJI
- 北口 浩嗣 JUKIオートメーションシステムズ(株)

実装プロセステクノロジー展実行委員会

- 委員長 吉川 英樹 ヤマハ発動機(株)
- 副委員長 杉友 庸一 パナソニックコネクタ(株)
- 委員 中井 俊輔 (株)FUJI
- 公文 暁子 JUKIオートメーションシステムズ(株)
- 宮部 大樹 武蔵エンジニアリング(株)
- 伊佐 吉史 オムロン(株)

実装プロセステクノロジー展企画部会

- 委員長 吉川 英樹 ヤマハ発動機(株)
- 副委員長 杉友 庸一 パナソニックコネクタ(株)
- 委員 中井 俊輔 (株)FUJI
- 公文 暁子 JUKIオートメーションシステムズ(株)

JPCA2025
Show

第54回国際電子回路産業展



マイクロエレクトロニクスショー

第39回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO
PROTEC 2025

第26回 実装プロセステクノロジー展

METaverse DEVICE EXPO
メタバースデバイス展



～装置と装置をつなぐ～

WIRE Japan Show
2025

電気・光伝送技術展

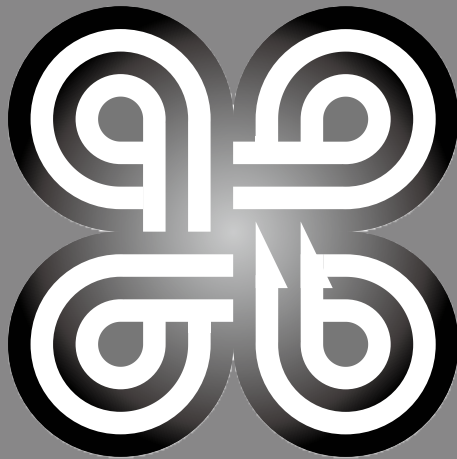
Electronics
Component & Unit
Show

JEP 全国電子部品流通連合会
東京電機機器商業協同組合



E-Textile/Wearable

イーテキスタイル/ウェアラブル展



電子機器2025 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2025

2025. 6. 4 Wed. → 6 Fri.

東京ビッグサイト 東展示棟 | Tokyo Big Sight, East Exhibition Hall

本部事務局 一般社団法人 日本電子回路工業会 ▼展示会に関するお問い合わせ / Inquiry▼
Organized by: JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association 本部事務局: 一般社団法人日本電子回路工業会 Organized by: Japan Electronics Packaging and Circuits Association
TEL: 03-5310-2020 E-mail: show@jpca.org

www.jpca.org
www.jpca.org

詳細は展示会ウェブサイトへ▶ www.jpca.org

▶お問い合わせ先 本部事務局: 一般社団法人日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org